



TRESKY

TRESKY T-3002-PRO SEMI-AUTOMATIC WAFER DIE BONDER

La die bonder semiautomatica Tresky T-3002-PRO è una macchina ad alta precisione che, controllata da un operatore, raccoglie, semiconduttori puri da wafer con diametro fino ai 200 mm (8") o da waffle e gel pack da 2/4", componenti passivi e altri dispositivi utilizzati in microelettronica, e li posiziona sui relativi assembly.

La Tresky T-3002-PRO controlla tramite PC tutti i parametri di bonding e i profili di temperatura con immagini in tempo reale del Beam Splitter Optics e della Process Inspection Camera.

I sistemi PRO incorporano un asse Z motorizzato, fornendo una misurazione della forza attiva su ogni pickup e su ogni posizionamento rimuovendo la variazione indotta dall'operatore. Questo è l'ideale per il bonding di dispositivi delicati e per fornire un controllo preciso dello spessore di ogni singolo bond.

Grazie a un design avanzato ed ergonomico, e un'ampia possibilità di personalizzazione dei requisiti di assemblaggio questa macchina è l'ideale per la ricerca e lo sviluppo.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TRESKY T-3002-PRO SONO:

- controllo completo tramite PC
- asse Z motorizzato (tolleranza della posizione ± 0.001 mm) con controllo della forza di bonding
- forza di bonding da 20 g a 400 g (altri range disponibili) con tolleranza ± 1 g
- DIE EJECTOR SYSTEM per il pickup dai wafer
- base per waffle/gel pack, supporto per substrati e varie piastre di riscaldamento
- dimensione massima del PCB / substrato di 400 mm x 280 mm
- area di assemblaggio di 220 x 220 mm con controllo micrometrico e ammortizzamento a cuscinetti d'aria
- range di movimento dell'asse Z di 95 mm con rotazione di 360°
- TRUE VERTICAL TECHNOLOGY™ che garantisce il parallelismo tra il chip e il substrato ad ogni altezza di bond
- precisione di posizionamento ± 10 μ m (± 1 μ m opzionali)
- dimensioni 900 mm x 800 mm x 700 mm
- peso 90 kg

MODULI COMPATIBILI:

- EUTECTIC
- FLIP-CHIP ULTRA
- FLIP-STATION
- STAMPING & FLUX
- ULTRASONIC
- UV CURING

POSSIBILI APPLICAZIONI*:

- Die Attach, Die Sorting
- Flip-Chip
- 3D Packaging

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89
info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.

www.elexind.it 

- MEMS
- MOEMS
- VCSEL
- Photonics
- Ultrasonic
- Thermosonic
- RFID
- Sensor Assembly
- Adhesive Bonding
- UV Curing
- Eutectic Bonding (AuAu, AuSn, ...) e altro.

* potrebbero essere necessari moduli aggiuntivi